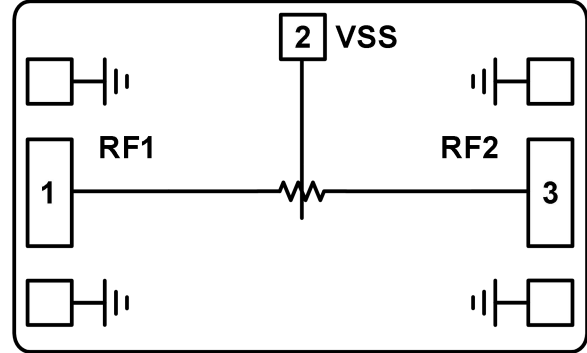




主要特点

- 插入损耗: 3.5dB
- 衰减补偿范围: 3dB
- 温度补偿范围: -55~ +85°C
- 输入输出回波损耗: 20 dB
- 电压控制: -4.6 V
- 芯片尺寸: 0.76×0.76 × 0.075 mm³

功能框图

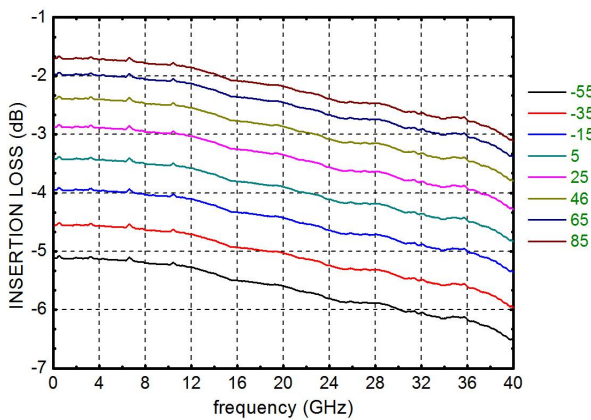


性能指标 (T = +25°C, VSS = -4.6 V)

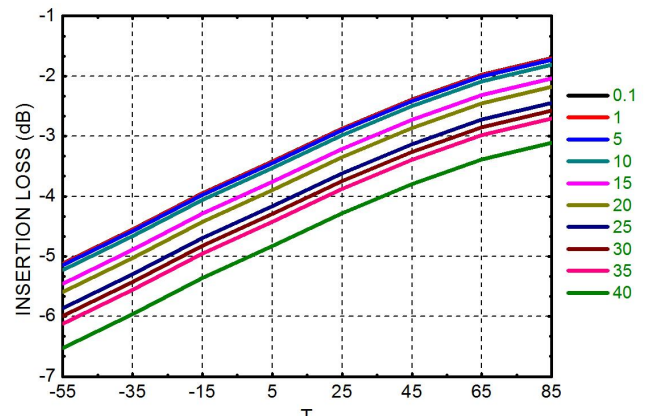
参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	DC~40			GHz
插入损耗	3	3.5	4	dB
衰减补偿范围	3			dB
温度补偿范围	-55~+85			°C
输入回波损耗	20			dB
输出回波损耗	20			dB

注: 若在使用时发现温补范围小于手册值时, 可对 VSS 电压进行调整, 调整范围应在-4.7V ~ -4.4V 区间内。

插入损耗 VS 频率

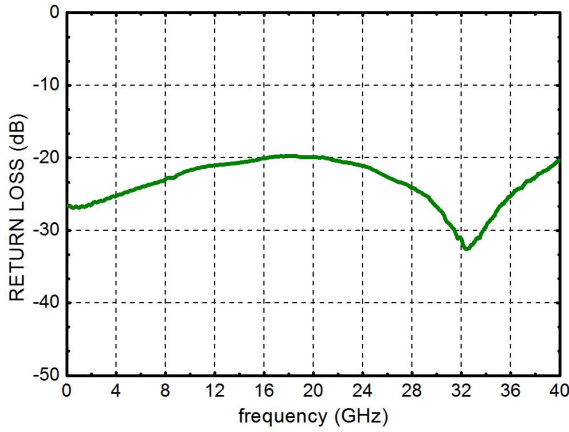


插入损耗 VS 温度

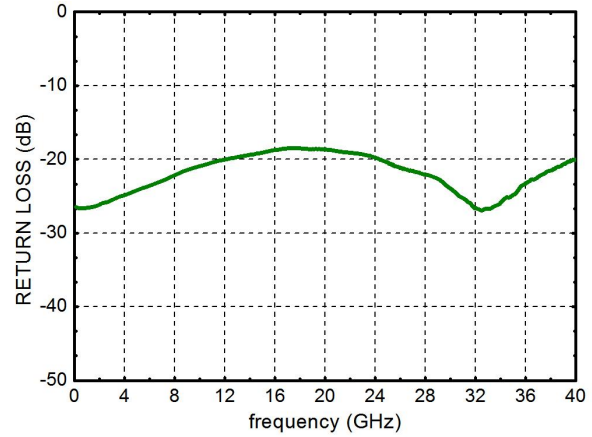




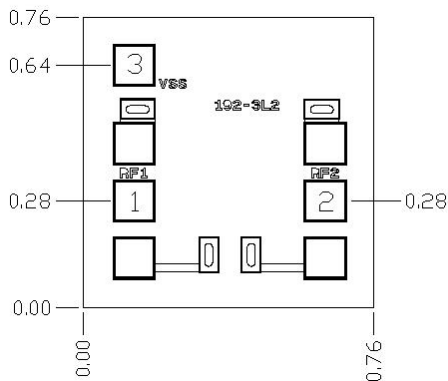
输入回波损耗



输出回波损耗



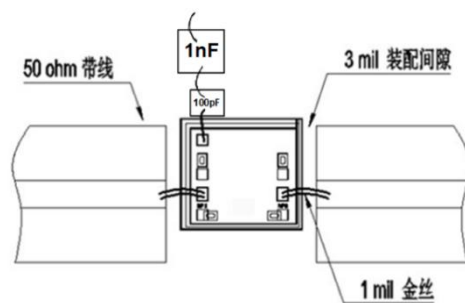
物理参数



焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1, 2	RF1, RF2	该系列焊盘射频支路端, 如果 RF 电位不是 0V, 那么需要外部加入隔直电容
3	VSS	电源输入端, 需要外接 100 pF 和 1 nF 旁路电容
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地

装配图



注意事项

1. 芯片厚度为 75um
2. 典型键合焊盘尺寸为 100*100um²
3. 键合焊盘金属化: 金
4. 芯片背面镀金
5. 芯片背面接地
6. 未标注的键合焊盘不需要连接

极限参数

1. 电源电压: -7V
2. 射频输入功率: +20 dBm
3. 储存温度: -55~+150°C
4. 工作温度: -55~+125°C